

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3677035号  
(P3677035)

(45) 発行日 平成17年7月27日(2005.7.27)

(24) 登録日 平成17年5月13日(2005.5.13)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

F I

G 0 6 F 3/03

G 0 6 F 3/03 3 4 O

G 0 1 B 17/00

G 0 1 B 17/00 B

G 0 6 F 3/033

G 0 6 F 3/033 3 6 O A

請求項の数 6 (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願平5-513237  
 (86) (22) 出願日 平成5年1月7日(1993.1.7)  
 (65) 公表番号 特表平8-511362  
 (43) 公表日 平成8年11月26日(1996.11.26)  
 (86) 国際出願番号 PCT/US1993/000076  
 (87) 国際公開番号 W01993/015489  
 (87) 国際公開日 平成5年8月5日(1993.8.5)  
 審査請求日 平成12年1月6日(2000.1.6)  
 審判番号 不服2003-22876(P2003-22876/J1)  
 審判請求日 平成15年11月25日(2003.11.25)  
 (31) 優先権主張番号 820,517  
 (32) 優先日 平成4年1月14日(1992.1.14)  
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(73) 特許権者 503431873  
 エクゼク、インコーポレイティド  
 アメリカ合衆国、イリノイ 60201,  
 エバンストン、オーク アベニュー 184  
 O  
 (74) 代理人 100077517  
 弁理士 石田 敬  
 (74) 代理人 100089819  
 弁理士 平岩 賢三  
 (74) 代理人 100082898  
 弁理士 西山 雅也  
 (72) 発明者 ノールズ、テレンス ジェイ.  
 アメリカ合衆国、イリノイ 60201,  
 エバンストン、オーク アベニュー 184  
 O

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 音響的タッチ・ポジション・センサーのためのタッチ・パネル

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

内部の伝播のために所定の波長のセン断波を伝播するために取り付けられている少なくとも一つのトランスジューサーを備え、タッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネルであって、

内部伝播によりセン断波を伝播可能であり、前記トランスジューサーが接続されたタッチ基板と、

バック・プレートと、

前記タッチ基板と前記バック・プレートの間に置かれ、本質的にセン断波を伝達しない液状接着剤であって、前記タッチ基板を前記バック・プレートに接着し、かつ前記タッチ基板を伝播するセン断波が前記バック・プレートに伝達されることを本質的に防止する液状接着剤と、からなるタッチ・パネル。

## 【請求項2】

前記タッチ基板の厚みが、前記タッチ基板中に伝達されるセン断波の波長の2倍より小さい、請求項1に記載のタッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネル。

## 【請求項3】

前記タッチ基板の厚みが、前記タッチ基板中に伝達されるセン断波の1つの波長より小さい、請求項1に記載のタッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネル。

## 【請求項4】

前記タッチ基板の厚みが、前記タッチ基板中に伝達されるセン断波の波長の0.9倍より

小さいか、または前記タッチ基板中に伝達されるセン断波の波長の1.1倍より大きいがセン断波の2倍より小さい、請求項1に記載のタッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネル。

【請求項5】

前記タッチ基板が軸に沿って配置されている反射要素の配列構造を含み、前記配列構造の各要素が前記配列構造の軸に関して45°の角度で置かれていて、かつ前記配列構造を幅方向に横断して前記軸に垂直に延びるラインと交差する反射要素の数が14以上となる、請求項1に記載のタッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネル。

【請求項6】

請求項1に記載のタッチ・ポジション・センサー中で使用されるタッチ・パネルであって 10

、  
前記タッチ・ポジション・センサーが、前記タッチ・パネルの1つの軸に沿って伝播するセン断波を第1の方向において送信し、かつ前記軸に沿って伝播するセン断波を前記第1の方向と対向する第2の方向で受信するための1つのトランスジューサーを具備し、  
前記タッチ基板が前記軸に沿って配置される反射要素の配列を具備し、かつ前記反射要素の各々が前記配列の軸に対して45°の角度で取り付けられるとともに、前記タッチ基板が前記配列の第1の端部の近傍に前記トランスジューサーを取り付けるための第1のエッジと、前記配列の第2の端部の近傍に反射性で且つ前記軸に対して45°の角度に位置している前記第1のエッジの反対側の第2のエッジと、を有するタッチ・パネル。

【発明の詳細な説明】

20

これは1990年11月26日に提出されたアメリカ特許出願番号07/615,030の一部継続出願である。

技術的な分野

本発明は、音響タッチ・ポジション・センサーに関し、特に音響タッチ・ポジション・センサーに使用するタッチ・パネルであって、偽音響波を抑制しかつ薄いあるいは厚いパネルとして形成され内部を伝播するセン断波の伝播可能なタッチ・パネルに関する。

発明の背景

音響タッチ・ポジション・センサーは、パネルの第1の末端に沿って置かれている送信器のグループを備えたタッチ・パネルまたはプレートを、第1の末端と反対側のパネルの第2の末端に置かれている検出器のグループにX方向でパネルを介して伝播するレイリー波を同時に生成するために含んでいることが知られている。送信器のグループも、第3の末端と反対側のパネルの第4の末端に置かれている検出器のグループにY方向でパネルを介して伝播するレイリー波を同時に生成するためにパネルの第3の末端に沿って置かれている。パネルをタッチして交差する波を妨げると、独特な出力信号が、交差のポイントを定めるX検出器とY検出器で生成される。このような音響タッチ・ポジション・センサーがアメリカ特許No.3,673,327に図示されている。 30

音響タッチ・ポジション・センサーは、1つの軸に2つのトランスジューサーだけ要求されることも知られている。各々軸に対して、1つのトランスジューサーは、第1の反射格子が異なる長さの複数の平行する通路に沿う表面音響波を第2の反射格子に反射するために配置されている、垂直軸に沿って伝播する表面音響波を送る。第2の反射格子は、表面音響波を、信号が処理のために受信される第2のトランスジューサーに反射する。X軸に関連する反射格子は、格子パターンを与えて、プレートのタッチの座標を決定するために、Y軸に関連する反射格子と垂直に位置している。このタイプの音響タッチ・ポジション・センサーはアメリカ特許No.4,642,423, 4,644,100, 4,645,870, 4,700,176, 4,746,914, 4,791,416に図示されている。 40

前述の特許が考案したようにして表面音響波を活用する音響タッチ・ポジション・センサーは、これらのセンサーに用いられる表面音響波の特性を考慮すると、更に容易に理解される数多くの問題をかかえている。前述の特許の場合、タッチ・プレートが均一で非圧電媒体からなっていて、なおかつ、音響波がタッチ・プレートの他の表面のような外面でもしくはその近くで限定される時に、表面音響波はレイリー波と呼ばれる。これらの波はX 50

とZ成分を含んでいるので、乱れた動きをする粒子がX-Z面を楕円のように動く。これらの波の特長として、乱れた動きは、深くなるにつれて、すなわちZ方向に於いて放射状になるので、波のエネルギーはタッチ・プレートの表面または其の近くに基本的に限定される。厳密にいうと、レイリー波は無限の厚みの媒体にしか存在しない。波は、1つの表面に限定される一定の厚みをもつ均一の非圧電媒体に於いて、図1A-1Dの上段図に図示されているように、更に具体的に準レイリー波と呼ばれている。一定の厚みの媒体に於いて長い適切な伝搬通路が与えられると、レイリー波のエネルギーは、1つの表面または其の近くに限定されないが、プレートの外面の間で前後に移動する。前述の特許に従うタッチ・センサーは、これらの条件のともで作動できないと思われる。何故ならば、波が反対側の外面に完全に伝わるある外面の領域に於けるタッチは波を乱さないもので検出できないためである。実際に、1つの表面に限定される波を与えるために、タッチ・プレートの厚みは基板に送られる波の波長の少なくとも3~4倍でなければならない、また、タッチ・プレートの厚みと幅も限定されることになる。

タッチ・プレートの厚みが例えば2つのレイリーの波長と等しいか小さい時に、前述の特許に用いられているソース・トランスジューサーから放出する波はレイリー/準レイリー波と明らかに異なっていて、なおかつ、他の表面音響波(SAW)モードは図1Dの中段図と下段図に図示されるラムまたはプレート波と呼ばれている。ラム波は種々のオーダーの2つグループに存在し、その全てが互いに独自に伝搬する。1つのグループは、プレートの中間面に関して対称になる粒子変位を特徴にしている。他のグループのラム波は、中間面に関して非対称になる粒子変位を特徴にしている。一般的に、対称ラム波グループに属する特定のオーダーは、非対称ラム波の同じオーダーから位相とグループ速度において異なっている。特に、2つのレイリー波長とほぼ等しいプレートの厚みの場合、ほぼ等しい振幅の2つのモード、すなわち、ゼロ番目のオーダーの対称ラム波とゼロ番目のオーダーの非対称ラム波が、主として励起される。図1Dの中段図と下段図に見受けられるように、対称および非対称ラム波は、タッチ・プレートの1つの表面に限定されないが、プレートを介してその反対側の表面に延長する。しかし、波の発生源からかつその近くから始まる位相では、2つのラム波は、図1Dの中段図および下段図と図1Dの上段図とを比べると分かるように、準レイリー波を生成するようにして結合している。2つのラム波モードが発生源から更に移行すると、異なる位相速度と其れらの間の最終的な位相差のために、波を生成するトランスジューサーが反対側の外面に取り付けられている外面から、波エネルギーは完全に伝わることになる。このプレートの外面間のエネルギーの伝わりは、一定の空間が開けられた間隔で生じて、この伝わりが行われるには大きすぎる寸法形状となるので、タッチ・ポジション・センサーにとって不安定な状態になる。

前述の説明から、これらのセンサーを必要に応じて作動するために、表面音響波、特に準レイリー波を活用する前述の特許に図示されているタッチ・ポジション・センサーは、比較的厚いパネル、すなわち、そこを伝播する表面音響波の波長の3~4倍の厚みをもつパネルに限定される。更に、準レイリー波は1つの表面とその近くに限定される。前述の特許に従う準レイリー波を使用する結果として、幾つかの好ましくない属性、すなわち、汚染物またはタッチ・パネルに付着する他の物質に対する過度な敏感性、および数多くの応用事例に対応するために過度な重量と厚みを導くことになる。汚染物に対する過度な敏感性は、限定面または其の近くに於ける波エネルギーの限定性に起因する。準レイリー波エネルギーまたはその大部分は常識的な量の表面汚染物でも吸収する。汚染物、密閉剤、またはプレートに付着する他の物質に依る波エネルギーの大雑把なあるいは全体的な吸収作用は、汚染物と交差する軸に沿って延長する音響的な陰またはブラインド・スポットを作る。前述の特許に従うタッチ・ポジション・センサーは、片方または両方の座標がブラインドされる軸にある時にタッチを検出できない。ある意味で、準レイリー波を活用するタッチ・パネルは汚染物または付着物に対して過度に敏感になる。前述の特許に従うタッチ・センサーの特性を最適にする範囲は、タッチ感度と最小限度のタッチ・パネルの厚みを独自に選択できないので限られることになる。準レイリー波を薄くされた厚みのタッチ・パネルでサポートする場合、その他の寸法形状を同じままに保つとすると、波長は1つの

10

20

30

40

50

表面の限定を維持するために短くしなければならない。レイリー／準レイリー波の特徴として、それらの限定される深さは波長に関係していて、波長が短くなるにつれて限定される深さも減少する。その結果、波長は表面のために制限される浅い領域に限定され、なおかつ、与えられた吸収媒体に依って吸収される波エネルギーの比率が大きくなる。実験から、これは波長の逆2乗にほぼ比例して変動することが分かっている。前述のように、前述の特許に従うタッチ・センサーは、比較的厚いパネルの場合でも或る応用事例に於いて過度に敏感になると考えられる。従って、タッチ・パネルの厚みを薄くすると、タッチ・センサーは表面汚染物または他の付着物に対して更に敏感になる。逆に、準レイリー波の波長を大きくして感度を下げると、パネルの厚みと重量が大きくなる。表面音響波の空気制動の結果として距離に対する波エネルギーの損失も大きくなる。何故ならば、表面音響波がタッチ・プレートの表面に限定されるからである。空気制動に起因するエネルギー損失はタッチ・プレートのサイズを更に制限する。

10

図1AとCに図示されているように、表面音響波は、トランスジューサーがタッチ・プレートの表面音響波を送るためにウェッジを伝播するバルクを作るために図示される方向で振動する、プレートのタッチ表面に順に取り付けられているウェッジの上に取り付けられているトランスジューサーを活用するタッチ・プレート中に送られる。このタイプの波生成装置にも幾つかの欠点がある。装置は加圧バルク波を表面音響波に変換しなければならないので、装置の効率は、トランスジューサー生成波がプレートに送られたものと同じタイプになる、すなわち方向変換のようになるので、実際に高くない。また、ウェッジはプレートの上方を延長するので、それもプレートの取付のために考慮しなければならない。ウェッジは普通はプラスチック製なので、ウェッジをガラス・プレートに接着することが難しい。更に、トランスジューサーをウェッジに接着し、次にウェッジをタッチ・プレートに接着しなければならない。数多くの接着が要求されながら、信頼性を高めなければならない問題のために、この表面音響波生成装置は、僅かな接着しか要求しない他の波生成装置と比べると信頼性が低くなる。

20

表面音響波以外の音響波は、ラム波とセン断波を含めた波のように、固形物を伝搬できるが、今まで、これらの他の音響波はタッチ・ポジション・センサーに対して不安定になると考えられていた。ラム波は、それらが互いに干渉するように位相と速度を変えながら放散するので不安定であると考えられていた。セン断波も不安定と考えられていた。何故ならば、セン断波が伝搬するプレート上のタッチは、表面音響波が伝搬するプレート上のタッチが遮断された表面音響波エネルギーの大部分を吸収する、タッチされた表面に依って遮断されたセン断波エネルギーの僅かの部分しか吸収しないからである。特に、与えられたタッチが吸収する遮断されたエネルギーの部分は、実際のタッチ・プレートの厚みに対してゼロ番目のオーダーの水平に分極されたセン断波の場合よりも、表面音響波に対して10倍以上になる。セン断波は表面音響波ほどタッチに対して応答しないので、セン断波は、タッチ・ポジション・センサーに対して現実的でないと考えられる。

30

#### 発明の要約

本発明に従って、前述の従来の音響タッチ・ポジション・センサーの欠点を解決することができる。本発明のタッチ・ポジション・センサーは、基板の上のタッチが基板のタッチのポジションを決定するために感知される場合に振動を形成する、異なる長さで異なるポジションをもつ複数の通路に沿う基板を伝搬するセン断波を使用している。

40

セン断波は、幾つかの考えられないような長所を、タッチに依って吸収される総エネルギーの僅かしか補償しない表面音響波と比べると備えている。ある考えられないような長所として、セン断波は、タッチ・プレートに適した非圧電基板の上で表面音響波より優れた効率を備えて生成され受信されることができる。そこで、ノイズ比に対して実質的に大きな信号が生成するので、信号処理すると、セン断波タッチ・ポジション・センサーは、センサーが表面音響波タッチ・ポジション・センサーとタッチに対して少なくとも同じ感度になる。

実際に、幾つかの長所をセン断波タッチ・ポジション・センサーから得ることができるのは、セン断波が、表面音響波のように、基板の表面に限定されず、基板の全体的な厚みの

50

全体にわたって延長するためである。1つの長所として、汚染物またはセン断波タッチ・ポジション・センサーの表面に付着する他の物質は、汚染物または物質と交差する軸に沿って延長するブラインド・スポットまたは大きな陰にならない。従って、セン断波タッチ・ポジション・センサーは、表面音響波センサーが適していない環境での使用に適している。セン断波タッチ・ポジション・センサーも基板の最上部と最下部の両面のタッチに対して反応するが、表面音響波センサーはトランスジューサーが取り付けられている基板の表面だけのタッチに対して反応する。更に、空気制動に起因する損失は表面音響波タッチ・ポジション・センサーの場合よりセン断波タッチ・ポジション・センサーの場合に小さいので、セン断波は、信号強度の与えられた低下に相応して表面音響波より長い距離を移動できる。

10

セン断波タッチ・ポジション・センサーの別の大きな長所として、事実上、タッチ・パネルの厚みに関する唯一の限界は、タッチ・センサーの重量を最小限にしなければならない応用事例に対して特に現実的なものにするその構造的な統合性だけである。実際に、セン断波タッチ・ポジション・センサーの基板の厚みはレイリー波をサポートできる厚みより小さいことが望まれる。何故ならば、基板が薄くなればなるほど、部分的な感度が向上するからである。

セン断波がサポートされるタッチ基板は薄いことが望まれるが、基板は、タッチ・センサーの感度に確認できるほど影響せずに、本発明に従って任意の厚みをもつ別のプレートに接着できる。

特に、本発明のタッチ・パネルは、そこでの伝播のためにセン断波をサポートできるタッチ基板を含んでいる。過度に高いオーダーのモードまたはオーバートーンを防止しながら、希望されたセン断波をサポートするために、基板の厚みは、基板に送られるセン断波の波長の約2倍より小さくなる。基板の厚みは、それが基板に送られるセン断波の1つの波長より小さいか大きくなるようにも選択される。

20

タッチ・パネルを与えるために、その厚みは基板に送られるセン断波の2つの波長より大きくなり、ラミネートされたタッチ・パネルが与えられていて、そこでは、任意に希望された厚みのバック・プレートがタッチ基板に接着されている。本発明の或る実施態様に於いて、基板をバック・プレートに接着する接着剤は、非セン断波結合材である。第2の実施態様に於いて、バック・プレートは、音響波がバック・プレートを伝搬する速度が、音響波が基板を伝播する速度より速くなるように選択されている。

30

本発明に従って、タッチ・パネルは、偽音響波を抑制する手段を更に含んでいる。本発明に関する、これらと他の目的と長所と新規な特徴は、その図示されている実施態様の詳細部と共に、次に示す説明と図面から更に明確に理解できる。

#### 【図面の簡単な説明】

図1Aは、従来技術の表面音響波伝搬プレートの斜視図である。

図1Bは、図1Aの従来技術のプレートを移行する表面音響波の拡大斜視図である。

図1Cは、図1Aに図示されている従来技術のプレートの側面断面図であり、プレートに生成する波の特性を示している。

図1Dの上段図はレイリー波の図解である。

図1Dの中段図は対称ラム波の図解である。

40

図1Dの下段図は非対称ラム波の図解である。

図2Aは、本発明に従うセン断波伝搬プレートの斜視図である。

図2Bは、図2Aのプレートを移行するセン断波の拡大斜視図である。

図3は、本発明の第1の実施態様に従うセン断波タッチ・ポジション・センサーの斜視図である。

図4は、図3に図示されている反射配列構造を形成する可変長反射要素の図解である。

図5は、図3に図示されているタッチ・ポジション・センサーの信号処理部を示すブロック図である。

図6は、本発明のセンサーのポジション決定動作を示すフローチャートである。

図7は、図6に図示されているソフトウェア・ルーチンに依ってコールされるタッチ・ス

50

キャン・ルーチンを示すフローチャートである。

図 8 は、図 3 のタッチ・ポジション・センサーに依って生成される X と Y 波形を示すグラフである。

図 9 は、表面音響波と比較した時のゼロ番目のオーダーで水平に分極されたセン断波の部分的な感度の違いを示すグラフである。

図 10 は、本発明に従うタッチ・ポジション・センサーの第 2 の実施態様の平面図である。

図 11 は、本発明に従うセン断波タッチ・ポジション・センサーの第 3 の実施態様である。

図 12 は、図 3 に図示されているセンサーに依って生成する波形と比較した時の、図 11 に図示されているセンサーに依って生成する波形を示すグラフである。

図 13 は、偽モード抑制反射器が配置されて、図 3 に図示されているタッチ・ポジション・センサーの平面図である。

図 14 は、吸収ストリップが取り付けられた、図 3 に図示されているタッチ・ポジション・センサーの平面図である。

図 15 は、トランスジューサーに細長い柔軟なコネクタに依って結合されているセン断波伝搬基板の部分斜視図である。

図 16 は、トランスジューサーが遮蔽された、図 15 に図示されているトランスジューサーと基板とコネクタの側面図である。

図 17 は、本発明に従うタッチ・ポジション・センサーの別の実施態様の平面図である。

図 18 は、図 5 に図示されているコンピュータに依って実現される自動セットアップ・プログラムを示すフローチャートである。

図 19 は、本発明に従うタッチ・ポジション・センサーの別の実施態様の平面図である。

図 20 は、本発明のタッチ・ポジション・センサーに使用するラミネートされた水平の断面である。

好まれる実施態様の詳細な説明

本発明のタッチ・ポジション・センサーは、図 2 A に図示されているセン断波 12 を伝搬できる基板 10 を含んでいる。基板 10 は、強化ガラスまたはスリガラス、プラスチック、メタル、またはセラミック製である。基板 10 は、図示されている平らなガラスとして更に形成されるか、または基板は湾曲される場合もある。

X 方向を伝搬するセン断波を導くために、圧電トランスジューサー 14 は、伝搬軸 X に対して垂直に位置する基板の末端に接着されている。トランスジューサー 14 は Y 軸に沿って振動するためにドライブ信号に応答し、そこでは、水平セン断波 12 がトランスジューサー 14 に誘導されそれに依って基板 10 に直接結合される。図 2 B に図示されているように、基板 10 に送られるセン断波 12 は、基板 10 の 1 つの表面に限定されないが、基板 10 の全体的な厚みにわたって延長する。セン断波の粒子は Y 方向に於いてだけ移動する。セン断波は中間面の周囲で対称または非対称になることが注目される。本発明の好まれる実施態様の場合、非分散性セン断波が採用されている。特に、この非分散性モードは、X 方向を移行する波に対して次に示すプレート解法のゼロ番目のオーダーになる。

$$U_x=0$$

$$U_y=A \exp 2 \quad i(-ft)$$

$$U_z=0$$

ここで、 $U_x$   $U_y$   $U_z$  は各々 X, Y, Z 方向の変位要素であり、A は定数、 $\lambda$  は波長、f は 1 秒あたりのサイクル数である。このセン断波は、ゼロ番目のオーダーで水平に分極されるセン断波または Zohps 波と呼ばれる (Physical Acoustic, Ed. W. P. Mason, Voll-Part, Academic Press 1964, New York and London を参照)。本発明の第 1 の実施態様に従うタッチ・ポジション・センサー 16 が、座標が決定されることを望まれる各々軸に関連するペアの送信と受信トランスジューサー 18, 20 と 22, 24 を備えて、図 3 に図示されている。タッチ・ポジション・センサー 16 は X 軸と Y 軸に各々関連する 4 つのトランスジューサー 18, 20 と 22, 24 を備えているので、タッチの X と Y の両方の座標が決定されるが

10

20

30

40

50

、1つの座標だけ、例えばX軸に沿う座標だけが希望される場合に、Y軸に関連するトランスジューサー22と24は削除されることができる。

図3に戻ると、本発明に従って、圧電トランスジューサー18, 20, 22, 24が導電性フリットを用いて側面26と32に接着されている。特に、トランスジューサーは、インジウム・ベース・ハンダに依って導電性フリットにハンダ付けされている。他のロウ付け技術も種々のメタルと共に使用して、トランスジューサーをフリットに接着できる。導電性フリットは、トランスジューサー20と22の間で基板10のコーナー周辺を延長できる接触面を形成するので、これらの2つの隣接するトランスジューサーに接続される別のグラウンド・ワイヤーを必要としない。トランスジューサー18, 20, 22, 24の高さとトランスジューサーを基板10に接着する導電性フリットの高さは基板10の厚みと等しいので、実質的に1つの対称モードのセン断波が基板10に生成される。圧電トランスジューサー18, 20, 22, 24は、任意の妥当な状態で基板の側面26と32から外側に突き出ないように薄くなっている。さらに、トランスジューサーは基板10の最上部または最下部の表面40と42の上部と下部に突き出ていないので、基板10は、トランスジューサーのための特殊な構造を必要とせずに、同じサイズのプレートを配置できる任意の構造に取り付けることができる。

X軸を定めるために、X伝送トランスジューサー18が基板10の末端26に接着されていて、そこでは、末端26はX軸と垂直に位置している。伝送トランスジューサー18は、Y軸に沿って振動して、次に詳細に説明される反射要素の配列構造28に対してX軸に沿って移動するセン断波を送る。反射配列構造28の各々要素は、反射配列構造30に置かれていて対応する反射要素に対してY方向でそこに入射するセン断波の一部を反射するように、約45°の角度で置かれている。反射要素の配列構造30は、反射配列構造28が置かれている軸と平行に位置する軸に沿って置かれている。配列構造30の反射要素の各々は、Y方向に伝搬するセン断波を反射配列構造28から受信トランスジューサー20に反射するように、配列構造30の軸に関して45°の角度に置かれている。受信トランスジューサーは、セン断波を表す信号を与えるために、配列構造30で反射されるセン断波を感知するように、配列構造30の軸と垂直の基板10の側面26に接着されている。同様に、Y軸を定めるために、Y伝送トランスジューサー22が基板10の末端32に接着されていて、そこでは、末端32はY軸と垂直に位置している。伝送トランスジューサー22は、X軸に沿って振動して、次に詳細に説明される反射要素の配列構造34に対してY軸に沿って移動するセン断波を送る。反射配列構造34の各々要素は、反射配列構造36に置かれていて対応する反射要素に対してX方向でそこに入射するセン断波の一部を反射するように、約45°の角度で置かれている。反射要素の配列構造36は、反射配列構造34が置かれている軸と平行に位置する軸に沿って置かれている。配列構造36の反射要素の各々は、X方向に伝搬するセン断波を反射配列構造34から受信トランスジューサー24に反射するように、配列構造36の軸に関して45°の角度に置かれている。受信トランスジューサー24は、セン断波を表す信号を与えるために、配列構造36に依って反射されるセン断波を感知するように、配列構造36の軸と垂直の基板10の側面32に接着されている。

配列構造28と30の反射要素は異なる長さをもつ数多くの通路を定めるので、配列構造28の各々次の要素に依って反射されるセン断波は、次第に長くなる受信トランスジューサー20の通路を進む。反射配列構造28と30に依って定められる通路の各々の部分はY方向に於いて基板10と平行に延び、各々平行する通路部はX座標を定める。

同様に、配列構造34と36との反射要素は異なる長さをもつ数多くの通路を定めるので、配列構造34の各々次の要素に依って反射されるセン断波は、次第に長くなる受信トランスジューサー24の通路を進む。反射配列構造34と36とによって定められる通路の各々の部分はX方向に於いて基板10と平行に延び、各々平行する通路部はY座標を定める。

各々受信トランスジューサー20と24とによって生成されるXとY信号が図8に描かれているが、そこでは、可変高さをもつ反射配列構造28, 30, 34, 36は、その振幅

10

20

30

40

50

が次に説明される時間で実質的に一定の状態を保つXとY信号を与えるために採用されている。X軸信号に関して、セン断波が時間 $t_0$ から始まるトランスジューサー20によって生成される場合、トランスジューサー20によって受信される第1のセン断波は、 $2t_1 + t_2 + t_0$ に等しい時間に発生する。ここで、 $t_1$ は、セン断波が基板側面26から配列構造28の第1の反射要素に移行する時間であり、なおかつ、セン断波が配列構造30の第1の反射要素からトランスジューサー20によって感知される側面26に移行する時間でもある。関係式に於いて、 $t_2$ は、セン断波がY方向で基板10を横断する時間である。反射配列構造28の最後の要素に依って反射されかつ反射配列構造30の最後の要素に依って受信されるセン断波部は、 $2t_1 + t_2 + 2t_3 + t_0$ に等しい時間にトランスジューサー20によって受信される。ここで、 $t_3$ は、セン断波が反射配列構造28の第1の要素と反射配列構造28の最後の要素の間でX方向に於いて移行する時間と、セン断波が配列構造30の最後の要素とその第1の要素の間でX方向に於いて移行する時間を表している。同様に、トランスジューサー22がセン断波を時間 $t_0$ で生成すると、受信トランスジューサー24は時間 $2t_1 + t_3 + t_0$ で配列構造34と36に依って反射された第1のセン断波を受信し、受信トランスジューサー24は時間 $2t_1 + t_3 + 2t_2 + t_0$ で配列構造34と36に依って反射された最後のセン断波を受信する。 $2t_1 + t_2 + t_0$ と $2t_1 + t_2 + 2t_3 + t_0$ の間の $t_x$ の各々の値はX軸に沿う座標を表している。 $2t_1 + t_3 + t_0$ と $2t_1 + t_3 + 2t_2 + t_0$ の間の $t_y$ の各々時間の値はY軸に沿う座標を表している。好まれる実施態様に於いて、ドライブ信号がY軸伝送トランスジューサー22に印加される時間は、ドライブ信号をX軸伝送トランスジューサー18に印加する次の時間になり、なおかつ、X軸受信トランスジューサー20が配列構造28と30によって反射された最後のセン断波を受信する時間の次になることが注目される。

基板10の外部すなわち最上部の表面40またはその内部すなわち最下部の表面42のタッチは、タッチされたポジションの下方または上方を通るセン断波のエネルギーの一部を吸収する。このエネルギーの部分的な吸収は、そのエネルギーが吸収されるセン断波の摂動を生成し、その摂動は受信トランスジューサー20と24によって生成された信号の振幅で反射される。例えば、基板10の最上部または最下部の表面のタッチの座標は、図8の $t_{Tx}$ と $t_{Ty}$ において各々描かれているXとYのトランスジューサー信号に於ける摂動の発生の時間によって表される。

タッチ・ポジション・センサーの制御システムは、図5に図示されているように、トランスジューサー18と22に対するドライブ信号の印加を制御し且つタッチを示す信号摂動の発生 $t_{Tx}$ と $t_{Ty}$ の時間から基板10のタッチの座標を決定する。図5に図示されているタッチ・パネル70は、基板10とXY伝送トランスジューサー18と20、XY受信トランスジューサー20と24、および反射配列構造28, 30, 34, 36を搭載している。マイクロプロセッサなどを含んでいるホスト・コンピュータ72は、コントローラ74に命令して、タッチ・パネル70のスキャン・サイクルを始める。コントローラ74は、コンピュータ72からの開始スキャン・サイクル命令に応答して、ドライブ信号をX伝送トランスジューサー18にXドライバー76を経由して印加し、そこでは、コントローラ74のタイミングはクロック/オシレーター78によって決定される。トランスジューサー18に印加されたドライブ信号は、正弦波の形状のバースト・ドライブ信号であり、そのサイクル数は定数によって割り算された配列構造28の幅に等しい。コントローラ74は、X/Yスイッチ80をXポジションにセットして、X受信送信器20をR.F.増幅器82に結合する。配列構造28と30によって反射されたセン断波がトランスジューサー20によって感知されると、トランスジューサー20は、スイッチ80を経由して増幅器82に結合されているそれを示すX軸信号を生成する。増幅器82から出力され増幅されたX軸信号は、交流成分を増幅されたX軸信号から除去して、図8に図示されているような包絡線波形を与える。復調器84の出力は、デバイス86の入力がそのスレッシュホールドより高い時に入力に進む出力信号を与える、スレッシュホールド・デバイス86に結合されている。スレッシュホールド・デバイス86の出力は、しかし、入力がそのスレッシュホールドより低い時に入力信号に進まない。スレッシュホールド・デバイス86の

10

20

30

40

50



出力はアナログ／デジタル・コンバーター 88 に印加され、その出力は内部バス 91 にバッファ 90 によって結合される。コントローラ 74 はアナログ／デジタル・コンバーター 88 のデジタル・データ出力をスタティック RAM 92 に記憶するので、アナログ／デジタル・コンバーター 88 によってサンプル抽出された時間  $t_x$  の各々ポイントに於ける X 軸信号の振幅を示す値は、時間のポイントを示すスタティック RAM 92 のロケーションに記憶される。X 軸データがスタティック RAM 92 に記憶された後に、コントローラ 74 は、Y ドライバ 76 を制御して、バースト・ドライブ信号をタッチ・パネル 70 の Y 軸伝送トランスジューサ 22 に印加する。コントローラ 74 は X / Y スイッチ 80 のステートも変更するので、Y 受信トランスジューサ 24 は R.F. 増幅器 82 に結合される。Y 軸信号をアナログ／デジタル・コンバーター 88 の出力として示すデジタル・データも同様にスタティック RAM 92 に記憶されるので、アナログ／デジタル・コンバーター 88 によってサンプル抽出された時間  $t_y$  の各々ポイントに於ける Y 軸信号の振幅を示す値は時間のポイントを示すスタティック RAM のロケーションに記憶される。

初期設定プロセス中に、ホスト・コンピュータ 22 は、タッチされていないパネル 70 に対してスタティック RAM 92 に記憶されている値に応答して、R.F. 増幅器 82 の利得をセットする。その出力はデジタル／アナログ・コンバーター 96 に結合されている。フィードバック・ループ 98 から与えられる自動利得制御と組み合わされているスレッシュホールド・デバイス 86 は、低域応答のゼロ・レベルをシフトして、タッチされたポイントとタッチされていないポイントを示すトランスジューサの出力信号の振幅の違いを大きくするので、タッチされたポイントは更に容易に検出できる。この技術は、生成したゾップス (Zophps) 波の信号ノイズ比率が非常に高いので可能になる。この特徴は、従って、図 9 に図示されている表面音響波と比較する時に、ゾップス波の部分的な感度の違いを部分的に補償する。

タッチ・パネル 70 のタッチのポジションを決定する際のホスト・コンピュータ 72 のオペレーションが図 6 に図示されている。システムの初期設定中に、スキャン・サイクルは、時間  $t_{x0}$  と  $t_{y0}$  のためにスタティック RAM 92 に記憶されていた X と Y の振幅値でタッチされていないパネル 70 に対して実施される。初期設定プロセス中に、時間  $t_{x0}$  と  $t_{y0}$  に於いて各々サンプル抽出されたポイントに相応する X と Y の振幅値は、スタティック RAM 92 から読み取られて、ホスト・コンピュータ 72 の RAM 101 に記憶される。初期設定が実施された後に、ブロック 100 で、ホスト・コンピュータ 72 は、 $t_{tx}$  と  $t_{ty}$  をゼロに等しい値に、変数 X と Y を 1 に等しい値にセットする。その後ブロック 102 で、コンピュータ 72 は、図 7 に図示されているタッチ・スキャン・ルーチンをコールする。タッチ・スキャン・ルーチンは、ホスト・コンピュータ 72 の RAM 101 に記憶されている終了休止常駐ルーチンである。ホスト・コンピュータ 72 は、タッチ・スキャン・ルーチンに従ってブロック 104 で、X 軸の R.F. 増幅器 82 の自動利得制御値を初期設定時に決定されていた値にセットする。その後ブロック 106 で、ホスト・コンピュータ 72 は、コントローラ 74 に命令して、X 軸のスキャン・バーストを始める。時間  $t_x$  の X 軸の値がスタティック RAM 92 に記憶された後に、ホスト・コンピュータ 72 は、ブロック 107 で Y チャンネルの自動利得制御値をセットし、ブロック 108 でコントローラ 74 に Y 軸のスキャンを始めることを命令する。時間  $t_y$  の Y 軸値がスタティック RAM 92 に記憶された後に、コンピュータ 72 は、ブロック 110 で、RAM 101 の終了休止常駐エリアにスタティック RAM 92 に於いて時間  $t_x$  と  $t_y$  に対して記憶されていた振幅値の各々を読む。その後、ブロック 112 で、コンピュータ 72 は、図 6 に描かれているルーチンに戻る。

時間  $t_x$  と  $t_y$  の X Y 軸の振幅値がホスト・コンピュータの RAM 101 にスタティック RAM 92 から読み取られた後に、ホスト・コンピュータ 72 はブロック 114 で、ブロック 100 において X が 1 に初期化される  $t_x$  に対して記憶されている振幅値と  $t_{x0}$  すなわち  $x = 1$ 、 $t_{10}$  に対して記憶されている振幅値との差  $t_{xD}$  を決定する。ここで、 $A t_{10}$  は初期設定ルーチン中に最初にサンプル抽出された時間に対して記憶されていた振幅値を表している。その後、ブロック 116 で、コンピュータは、 $t_{xD}$  の差の値がスレッシュホールド

10

20

30

40

50

ド値より大きいかどうかについて決定する。その場合、コンピュータ72は、ブロック118で、差の値 $t_{xD}$ がX軸に対して検出された最大の差の値を意味する $D_x$ より大きいかどうかについて決定する。 $t_{xD}$ が $D_x$ より大きい時に、コンピュータ72は、ブロック120で、 $D_x$ を差の値 $t_{xD}$ に等しくセットし、差の値の発生時間 $t_{tx}$ を $t_x$ に等しくセットする。ブロック122で、コンピュータ72は $x$ を1だけ大きくする。 $x$ がN(ブロック124でコンピュータ72に依って決定され、X軸に対してサンプル抽出された時間ポイントの数)より大きい時に、コンピュータ72は、ブロック114に戻って、次の差の値を決定する。差の値がアナログ/デジタル・コンバーター88によってサンプル抽出されかつ振幅値がRAM101に記憶されていた時間の各々ポイントに対してブロック114で決定された後に、コンピュータ72は、ブロック126で、 $t_{tx}$ (最も大きい振幅の違い $D_x$ の発生時間)がゼロかどうかについて決定する。 $t_{tx}$ がゼロに等しい(タッチがX軸上で検出されないことを示す)に、コンピュータ72はルーチンをブロック127から出る。しかし、 $t_{tx}$ の値がゼロと等しくなく、タッチがあり、発生時間が $t_{tx}$ と等しい時に、コンピュータ72はブロック128に進む。ブロック128で、コンピュータ72は、時間 $t_y$ で記憶された振幅と時間 $t_{y0}$ で同じポイントに対して記憶されていた初期設定値を比較して、その違いを $t_{yD}$ として記憶する。ブロック130で、コンピュータ72は $t_{yD}$ とスレッシュホールドを比較する。 $t_{yD}$ がスレッシュホールドより大きい時に、コンピュータ72は、ブロック132で、 $t_{yD}$ と $D_y$ (Y軸信号に対してブロック128で計算された最大の差の値)を比較する。その後、 $t_{yD}$ がブロック132の $D_y$ より大きいかどうかについて決定されるブロック134で、コンピュータ72は、 $D_y$ を $t_{yD}$ に等しく、最大差の信号 $D_y$ の発生時間 $t_{ty}$ を $t_y$ に等しくセットする。ブロック136で、コンピュータ72は、変数 $y$ を1だけ大きくして、ブロック138で、 $y$ とY軸信号のサンプル・ポイントの数 $Z$ を比較する。 $y$ が $Z$ と等しいか小さい時に、コンピュータ72はブロック128に戻る。 $y$ が差の信号がY軸で各々サンプル抽出されたポイントに対して計算されたことを示す $Z$ より大きい時に、コンピュータ72は、ブロック140で、タッチのXY座標を $t_{tx}$ と $t_{ty}$ の値から決定する。その後、ブロック142で、コンピュータ72はルーチンから出る。

本発明に従って、タッチ・パネルのサイズも図18に描かれているフローチャートに従って自動的に決定できるので、種々のサイズのタッチ・パネルが、マイクロプロセッサを制御する同じ命令セットと同じ電子システムを用いて使用できる。自動セットアップ・プログラムに入る時に、コンピュータ72はブロック200で、コントローラ74に、ドライブ信号を伝送トランスジューサー18に印加して、バーストを配列構造28に送ることを命令する。コンピュータ72は、最初のバースト信号が送られた時間を記憶する。その後、ブロック202で、コンピュータ72は、最初の信号がレシーバー20によって受信された時間を記憶する。ブロック204で、コンピュータ72は、最初に送信されたバーストに応答して生成された最後の信号がレシーバー・トランスジューサー20によって受信された時間を記憶する。コンピュータ72は、既知の、基板10を経由する波の速度を用いて、ブロック206で最初と最後に反射された波が移行した距離を、ブロック200で記憶された時間と各々ブロック202と204で記憶される時間から計算する。特に、コンピュータ72は、Y軸に沿うタッチ・パネルのサイズを、ブロック200と202で記憶された時間から決定する。コンピュータ72は、更に、X軸に沿うタッチ・パネルのサイズを、ブロック206で記憶された時間とブロック200と202で記憶された時間から決定する。ブロック208で、コンピュータ72は、タッチ・パネルの計算されたサイズを用いて、次に検出されるタッチ座標を自動的に調整して適正にする。

反射配列構造28, 30, 34, 36は、金属材料から作られていて、基板10の最上部の表面40に接着されている。しかし、本発明の好まれる実施態様に於いて、反射配列構造は、ガラス・フリットを基板10の最上部の表面40のステンシルを介してスクリーンして形成されている。反射配列構造フリットは、トランスジューサーを基板10に接着するために用いられる導電性フリットと同じサイクル中に形成される。前述のように、配列構造28, 30, 34, 36の各々反射要素は、その関連するトランスジューサー18,

10

20

30

40

50

20, 22, 24 に関して 45° の角度で置かれている。好都合に、配列構造の軸に沿う隣接する反射要素間の空間は、各々トランスジューサーに依って基板 10 に送られるセン断波の 1 つの波長と等しい。反射要素は好都合に 0.5 の波長幅になる。更に、各々反射要素 18, 20, 22, 24 の幅はトランスジューサーの幅と等しく、そこでは、トランスジューサーに印加されるドライブ信号が正弦波であり、そのサイクル数は前述のように定数で割り算された配列構造の幅と実質的に等しい。配列構造の幅部を延長するライン、すなわち配列構造の軸と垂直のラインと交差する反射要素の数は  $N = 14$  より小さくないことが更に分かった。これは、ゼロ番目のオーダーの非対称ラム波位相速度が 1.48 の波長比率に相応する基板厚みに於いてゾップスより約 7% 小さいためである。配列構造応答が  $(\sin NW) / (\sin W)$  によって定義されるゾップス波長から 7% より大きくない応答ゼロをも

10

各々反射配列構造 28, 30, 34, 36 の特性を高めて、セン断波とラム波を区別するために、配列構造の軸の右側の角度に於ける各々配列構造の反射器の数は、できるだけ大きくするように選択される。何故ならば、配列構造の識別品質は、配列構造の軸の右側の角度に与えられた音響通路の反射器の数に依存するからである。これは、軸の配列構造に沿って 1/2 波長の要素間の空間を維持して達成される。従来技術の表面音響波センサーの場合、反射配列構造に依って反射された表面音響波の一定のパワー密度を与えるために“反射要素回収”方法が採用されている。この方法は、配列構造に沿うポイントと各々トランスジューサーの間の距離が増加すると、配列構造に沿うポイントのパワー反射を増加

20

$$(2) \text{式} \quad \sigma(x) = \frac{\alpha}{(1 + \alpha/\sigma_L) \epsilon^{\alpha(L-x)} - 1};$$

30

x における配列構造の高さと最初 ( $x = 0$ ) の配列構造要素の高さの比率は、関係式 3 から与えられる。

$$(3) \text{式} \quad \frac{h(x)}{h(0)} = \frac{(1 + \alpha/\sigma_L) \epsilon^{\alpha L} - 1}{(1 + \alpha/\sigma_L) \epsilon^{\alpha(L-x)} - 1}^{1/2};$$

最後の配列構造要素と最初の配列構造要素の高さの比率は、関係式 4 から与えられる。

$$(4) \text{式} \quad \frac{h(L)}{h(0)} = \frac{(1 + \alpha/\sigma_L) \epsilon^{\alpha L} - 1}{\alpha/\sigma_L}^{1/2};$$

40

ここで、 $\sigma$  は単位長あたりの配列構造のパワー吸収性を意味し、x は配列構造の開始位置からの距離を示す変数であり、L は配列構造の長さを示している。種々の高さの配列構造をデザインするために、最大高さと最小高さの比率の実際の値  $h(L)/h(0)$  が、決定されて、関係式 (4) に代入されて、L を決定する。その後、 $h(0)$  と L の値が、関係式 (3) に代入されて、配列構造の高さを距離の関数として決定する。種々の高さの配列構造から、図 8 に図示されている波形が決まり、そこでは、配列構造要素に依って反射されるセン断波の振幅は、タッチのない配列構造に対して実質的に一定に保持される。

偽モードを減少する別の技術は、要素が与えられたゾップスモードの反射に対して偽モードの大きさを最小限にするように基板の厚み部を延長する状態で、配列構造の反射要素を形成している。これは、基板のスリットを希望された寸法にエッチングして、ガラス・フ

50

リットなどで埋め戻して、基板の厚み部を延長する反射要素をつくって達成できると考えられる。

更に別の技術は、最上部と最下部の反射要素が互いに実質的に垂直に並べられている場合に、基板の最上部と最下部の両方の表面の配列構造をスクリーンする。最上部と最下部の反射要素の垂直構造は偽の非対称ラム・モードを抵消に依って実質的に除去するが、ゾップスモードと対称のゼロ番目のオーダーのラム・モードの振幅が補強される。このようにして、希望された（ゾップス波）と好ましくない（ラム波）の信号振幅の比率は、約2のファクターによって増加される。

図13と14はラム波の干渉を更に減少する方法を示している。特に、図13に、偽モード（ラム波）抑制ストリップ反射器50が反射配列構造28, 30, 34, 36の各々の近くに置かれていて、ストリップ反射器50は関連する配列構造の軸と平行に延長している。反射器ストリップ間の空間は、抑制される波の波長の1/4に等しくなるように選択されている。図14に図示される代替実施態様に於いて、吸収材料52のストリップは、偽ラム波のエネルギーを吸収するために、基板10の最上部の表面40と最下部の表面42の両方の反射配列構造28, 30, 34, 36の各々の近くと正面に配置されている。ラム波はゾップス波に関して優先的に吸収され、なおかつ、残りのラムが事実上消滅しゾップスモードは無視できるほど減衰する。効果的な吸収ストリップはエポキシやシリコンなどから作られることができる。吸収ストリップはスクリーンされるか、または吸収テープが用いられる。吸収スクリーンの幅は、本実施態様に従って、配列構造の幅の25%または3mm以下で好都合になる。特定の応用事例の場合、タッチ・パネルは、密封剤を用いて低いリムまたは縁に貼られることが要求され、その場合、密封剤そのものは上部吸収ストリップに対して作用する場合もある。

リムまたは縁がタッチ・パネルの周辺を延長するために要求される応用事例に於いて、リムまたは縁は幅が制限されるので、それは反射配列構造と吸収ストリップを共にディスプレイの視界からマスクすることができない。この問題を緩和する非常に効果的な実施態様が図17に図示されている。ここで、配列構造28と30の反射要素は、図3に図示されている配列構造28と30に関して90°回転されている。ゾップス波は、ここで、基板の波エネルギーを反対側の末端222に再び送るために特に効率的な反射要素として作用する基板の隣接する末端220に外側に向けて反射される。末端反射時に、波は配列構造28を通り、波パワーの一部は左側に向けられる。反対側の末端72は、波を受信トランスジューサー20に順に送る受信配列構造30に波を反射し、同じエネルギーの一部は波が通る時に受信配列構造に依って右側に向けられる。この実施態様の目的は、基板10の最上部と最下部の両方の表面の末端220と222に近い配列構造28と30の後部に吸収テープ52を置いて、配列構造の前部の空間を自由にあることにある。反射通路は、各々吸収ストリップを2回、ストリップに向けて且つ其こから離れて横断するので、ストリップは、効果的に約2倍になり、その結果、幅を減少することができる。実際に、吸収ストリップの機能は、送受信ケーブルを基板の末端に限定するテープに搭載できる。ゾップスと偽ラム・モードの識別度は、末端反射後に配列構造を通る際に、信号通路からラム波の大部分を選別して除外する、配列構造の作用に依って更に向上する。僅か2つの配列構造28と30が単純にするために図17に図示されていることが注目される。本発明の更なる実施態様を示す他の図に図示されている配列構造の反射要素も、当業者にとって明らかであるように90°回転できる。

反射を除去または最小限にする光学的コーティングを備えているプラスチック・シートは、パネルの光学的な輝きを50%減少するために、基板10の最下部の表面にラミネートされることもできる。HEAコーティングを備えた適切なプラスチック・シートはOCL Iが製造している。このようなプラスチック・シートを使用すると、ラム・モード吸収器と強化ガラスの必要性をなくすと思われる。

ラミネートされたタッチ・パネルは、タッチ・パネルがそこを伝搬するセン断波をサポートできることを保証しながら、タッチ・パネルの厚みを厚くするためにも採用されると思われる。好都合に、基板10または基板300の厚みは、図20に図示されているように

10

20

30

40

50

ゾップス波の波長の2倍より小さい、すなわち、過度に高いオーダー・モードまたはオーバー・トーンを防止するために基板に作用される。更に、基板10と300の厚みは、基板に作用されるセン断波の1つの波長に特に近い値にすべきでない。これは、基板の厚みとセン断波の波長の比率が約1の場合に、反射要素の実際の配列構造、すなわち、一定の数の要素をもつ構造は、偽ラム波を拒絶できないからである。これは、約1の比率の時に第1オーダーの対称ラム波の位相速度はゾップスモードの速度とほぼ同じになり、配列構造はゾップス波とそのラム波を区別できないからである。従って、基板10と300の好ましい厚みは、セン断波長の0.9倍より小さいか、波長の1.1倍より大きい、波長の2倍より小さくなる。

基板に送られるセン断波の波長の2倍より大きいタッチ・パネルを与えるために、基板10と300はバック・プレートに接着され、そこでは、前述のように、バック・プレートに依るゾップス波の吸収または結合は実質的に存在しない。図20に図示されている適正にラミネートされたタッチ・パネルは、非セン断波結合材304を用いて、バック・プレート302を基板300に接着して形成される。適切な非セン断波結合材は、硬化後に液体のような状態を保つ接着剤、例えばシリコン・ラバー接着剤でよい。このような接着剤は、種々の応用事例にとっても重要なことは明らかである。このような液状の接着剤はセン断波をサポートできない、なおかつ、セン断波エネルギーは、圧縮成分を必要とするモード変換が存在しない場合に、接着剤に放出しないと思われる。境界層吸収はエネルギー損失の唯一のメカニズムになると思われる。

ラミネートされたタッチ・パネルは基板300をバック・プレート302に接着しても形成され、そこでは、音響波がバック・プレート302を移動する速度は、音響波が基板300を移動する速度より大きい。この後者の実施態様の場合、接着剤は、非セン断波結合になる必要はないが、例えばフリットになると思われる。この実施態様の場合、バック・プレート302と基板300の間のインタフェースは波エネルギーを止めるので、基板を伝搬するセン断波はバック・プレートに結合されないと思われる。任意の前述のラミネートされる実施態様のタッチ・パネルの場合、バック・プレートはガラスやプラスチックや金属またはセラミックから作られ、なおかつ、実施態様に基づいて、バック・プレートは基板と比較する時に同じまたは異なる材料から作られることもできる。

本発明のタッチ・ポジション・センサー16の第2の実施態様が、図10に図示されていて、タッチの座標が決定される、各々軸に関連するセン断波を送信し受信する1つのトランスジューサーを含んでいる。更に、図3に描かれている実施態様のように各々軸に対して2つの反射配列構造をもつ代わりに、図10に図示されているタッチ・ポジション・センサーは各々軸に対して1つの反射配列構造28と34を含んでいて、そこでは、各々配列構造28と34と反対側の基板10の側面32と44は反射末端を与えるように機械加工されている。セン断波は高効率で反射するので、基板10の反射末端32と44は、それに対して垂直に伝搬するセン断波を、任意に認識できるエネルギーの損失がない状態で反射する。

特に、トランスジューサー18は、Xドライバー76またはバースト・ゼネレーターをトランスジューサー18に、ドライブ信号をそこに印加する最初の周期で結合するために、コントローラー74によって制御される送信/受信スイッチ146に結合されている。トランスジューサー18は、ドライブ信号に応答して、配列構造28の軸に沿って伝搬する基板10にセン断波を送る。配列構造28の反射要素は、基板10の反射末端32にY方向の基板10に対してそこに入射するセン断波の一部を反射する。基板末端32は、それと垂直に伝搬するセン断波を、順にセン断波をトランスジューサー18に反射して戻す反射配列構造28に反射して戻す。ドライブ信号がトランスジューサー18に印加された後に、コントローラーは、送信/受信スイッチ146のステートを受信ポジションに相応して変更し、そこでは、トランスジューサー18がR.F.増幅器82に結合されているので、トランスジューサーによって感知されたセン断波はポジション検出回路に結合される。

同様に、トランスジューサー20は、Yドライバー76をトランスジューサー20に、ドライブ信号をそこに印加する第2の周期で結合するために、コントローラー74に依って

10

20

30

40

50

制御される送信／受信スイッチ１４８に結合されている。トランスジューサー２０は、ドライブ信号に応答して、配列構造３４の軸に沿って伝搬する基板１０にセン断波を送る。配列構造３４の反射要素は、基板１０の反射末端４４にＸ方向の基板１０に対してそこに入射するセン断波の一部を反射する。基板末端４４は、それと垂直に伝搬するセン断波を、順にセン断波をトランスジューサー２０に反射して戻す反射配列構造３４に反射して戻す。ドライブ信号がトランスジューサー２０に印加された後に、コントローラーは、送信／受信スイッチ１４８のステートを受信ポジションに相応して変更し、そこでは、トランスジューサー２０がＲ．Ｆ．増幅器８２に結合されているので、トランスジューサーによって感知されたセン断波はポジション検出回路に結合される。

配列構造２８に沿って移行するセン断波の一部が測定間隔中にトランスジューサー１８と反対側の末端４４から反射されることを防止するために、図１０に図示されているタッチ・パネルは図２０に図示されるようにして変更できるので、配列構造２８の末端４７に隣接する基板の末端４５は、配列構造３４の軸に関して４５°の角度になる。同様に、末端４９は配列構造３４の軸に関して４５°の角度になる。この実施態様の場合、吸収材料５２は、各々配列構造２８と３４の反対側の基板の末端３２と４４と隣接する基板の最上部と最下部の表面に置かれる場合もある。この吸収材料のポジションは、タッチ・ポジション・センサーの使用可能なタッチ・エリアを広くする。吸収材料５２は、これらの末端から反射された偽波を吸収するために、末端２６，３２，４３，４４の上に更に置かれる。しかし、吸収材料は角度の付けられた末端４５と４９に置くべきでない。トランスジューサーと基板の間のインタフェースで生成すると思われる偽波を更に最小限にするために、吸収テープを基板の最上部と最下部表面のトランスジューサーの正面に張るか、または接着末端５５をもつ銅ファイル５３をトランスジューサーの周囲に巻くか、あるいは両方を実施する。特に、銅ファイル５３は各々トランスジューサー１８と２２の周囲に巻かれていて、そこでは、ファイルの末端５５はトランスジューサーが取り付けられているプレート末端の間近の基板の最上部と最下部の表面に各々接着している。グラウンド・コネクションが与えられている銅ファイルは、電気的な干渉を和らげるシールドを形成し、なおかつ、更にプレートの周辺を延長する吸収材料の一部として作用する。配列構造２８と３４が基板の同じ最上部または最下部の表面に形成される必要がないことが更に注目される。例えば、基板２８は基板の最上部の表面に形成され、反射配列構造は基板の最下部の表面に形成される。このような構造は、製造などを容易にする長所を与えると思われる。

本発明のタッチ・ポジション・センサーの第３の実施態様が、図１１に図示されていて、タッチの座標が決定される２つの垂直する軸に関連するセン断波を送信し受信するために１つのトランスジューサーを含んでいる。この実施態様の場合、２つの反射配列構造が採用されていて、第１の反射配列構造２８はトランスジューサー１８が取り付けられている側面２６と垂直に位置する軸に沿って延長し、第２の反射配列構造３６は第１の配列構造２８の軸と垂直に位置する軸に沿って且つ配列構造２８の終端に隣接して延長している。反射配列構造２８の軸に沿って伝搬するセン断波を反射配列構造３６に結合するために、配列構造２８と３６の軸と交差する基板１０のコーナーは、基板１０の隣接する側面４４と４８に関して４５°の角度に置かれている反射末端４６を与えるために切り取られている。ドライバー７６のドライブ信号に応答して、トランスジューサー１８は、配列構造２８の軸に沿って伝搬する基板１０にセン断波を送る。配列構造２８の反射要素は、Ｙ軸と平行する複数の通路に沿うセン断波の部分を基板１０の側面３２に反射し、そこでは、側面３２は反射末端を与えるように機械加工されている。基板１０の側面３２は、其れと垂直に伝搬するセン断波を、順にセン断波を側面３２からトランスジューサー１８に反射して戻す配列構造２８に反射して戻す。反射配列構造２８の軸に沿って伝搬するセン断波が反射末端４６に到達すると、末端４６は第２の軸３６の軸に沿ってセン断波を反射する。第２の配列構造３６の要素は、-Ｘ方向の基板に対して平行する通路に沿うセン断波の部分を、第２の反射末端を与えるように機械加工されている基板１０の反対側の末端２６に反射する。基板側面２６は、それと垂直に伝搬するセン断波を、順にセン断波を反射末端４６に反射する第２の反射配列構造３６に反射して戻す。反射末端４６は、次にセン断波をト

10

20

30

40

50

ランスジューサー 18 に反射して戻す。ランスジューサー 18 は、反射して戻されたセン断波を感知して、それを示す信号を与える。このモードのオペレーションは三重伝送モードと呼ばれる。三重伝送モードに於いて、ランスジューサー 18 に依って与えられる信号の振幅は、図 3 に図示されているように、ランスジューサー 20 によって生成された信号の振幅と比べると減少している。この振幅の違いが図 12 に描かれている。好まれる実施態様に於いて、ランスジューサー 18 は最長の反射配列構造の軸と垂直に位置する基板 10 の側面に置かれているので、X 配列構造と Y 配列構造に関連する通路の長さ方向に重なりが生じないことが注目される。更に、好まれる実施態様に於いて、末端 32 は、配列構造 36 の終端に隣接する末端 32 の部分は、図 19 に関して既に説明されたように配列構造 36 の軸に関して  $45^\circ$  の角度になるように変更されている。

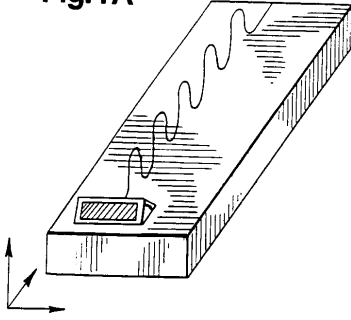
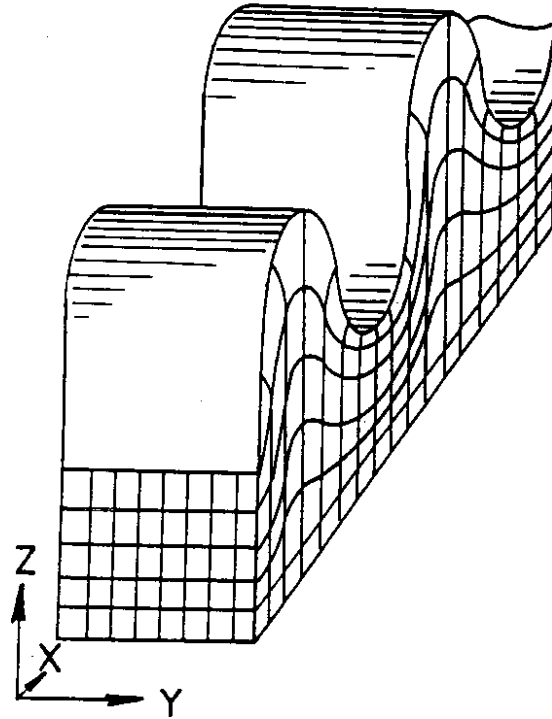
10

図 15 と 16 はゾップス・モード伝送ラインを形成するフレキシブル・コネクタ 60 を示している。特に、フレキシブル・コネクタ 60 は金属製であって、そこでは、基板 10 に接着されているコネクタの厚みは基板の厚みと等しく、コネクタ 60 の厚みはコネクタが接着されている基板の末端から短い距離になる希望された厚みに減少していて、その距離は数波長のゾップス波の単位になる。この実施態様は、ランスジューサーまたは電気配線がタッチ・プレートまたは基板 10 の近くにないので、ランスジューサーはコントローラーの内部でスリットなどを介してコントローラーのハウジングの壁に取り付けられることができるという長所を備えている。ランスジューサーはタッチ・プレート 10 から離れているので、電磁放射はランスジューサーから遮蔽されるので、ピックアップが減少する。更に、ランスジューサーから放出する任意の放射も外部ピックアップから同様に遮蔽される。フレキシブル・コネクタ・ストリップは 5 mil の薄さになる。更に、プラスチック保護被覆もコネクタ 60 をカバーすると思われる。何故ならば、保護被覆はそこを伝搬するゾップス波を大幅に減衰しないからである。

20

本発明の範囲から逸脱せずに前述の機器に変更が行われることができるので、前述の説明と図面は記述用と見なされ且つ限定するものでないことを意図されている。

次に示すのは、特許証に依って保証され且つ請求される範囲である。

【図 1 A】  
Fig.1A【図 1 B】  
Fig.1B

【図 1 C】

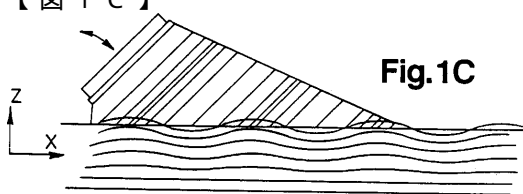


Fig.1C

【図 2 A】

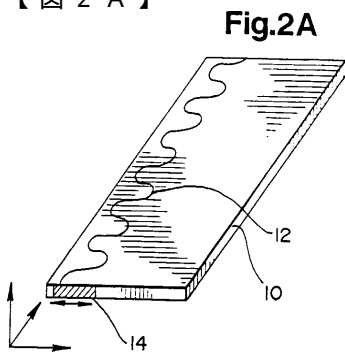


Fig.2A

【図 2 B】

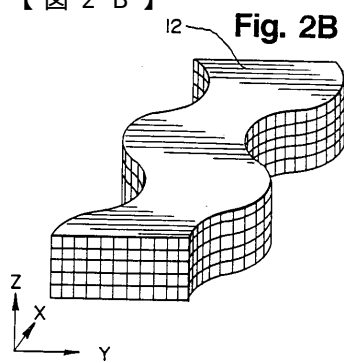


Fig. 2B

【図 1 D】

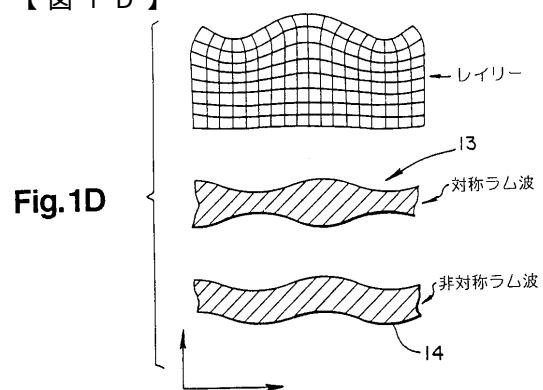


Fig.1D



【図 3】

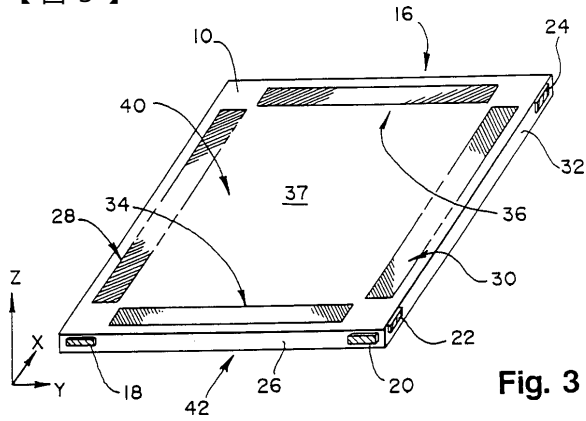


Fig. 3

【図 4】

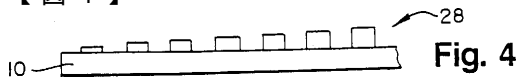


Fig. 4

【図 5】

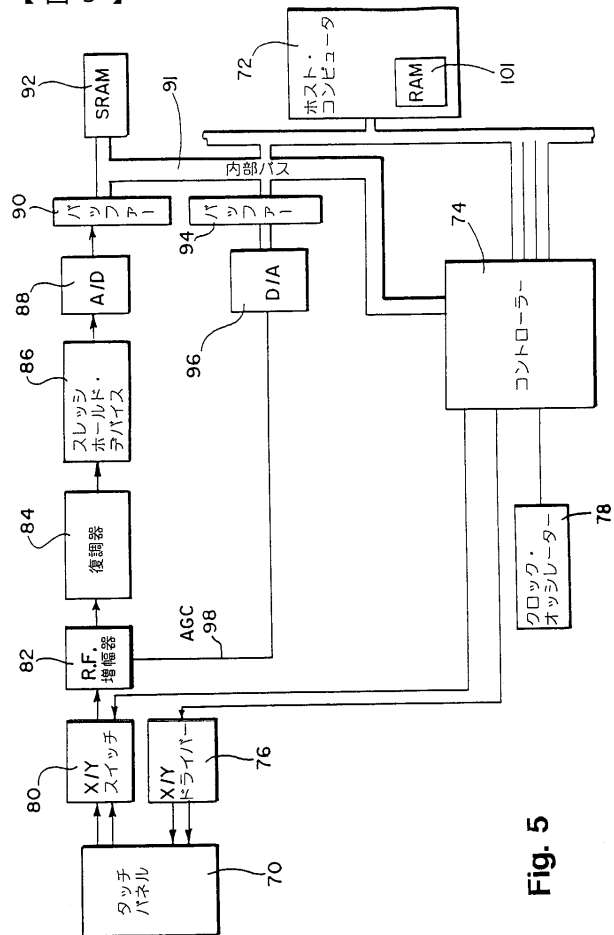


Fig. 5

【図 6】

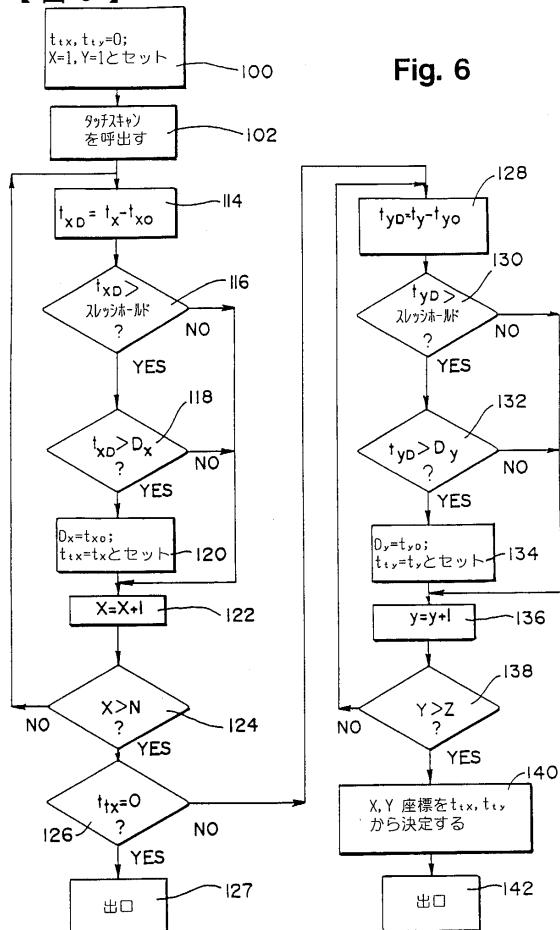


Fig. 6

【図 7】

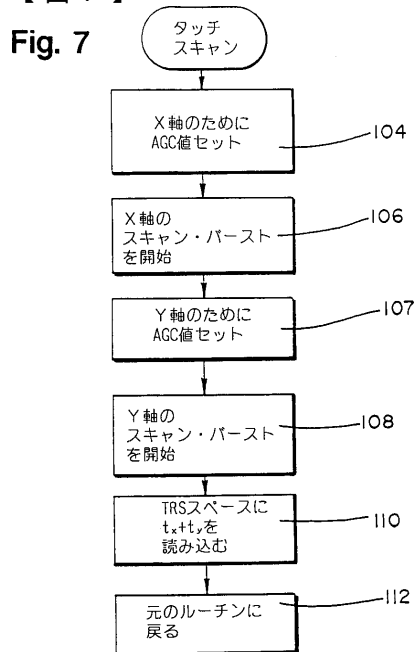
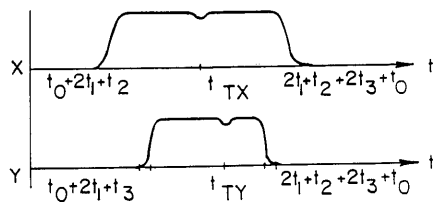
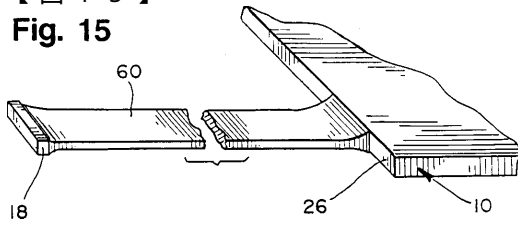


Fig. 7

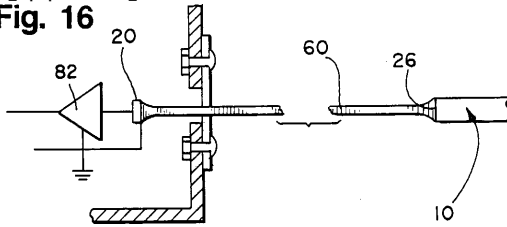
【 図 8 】  
Fig. 8



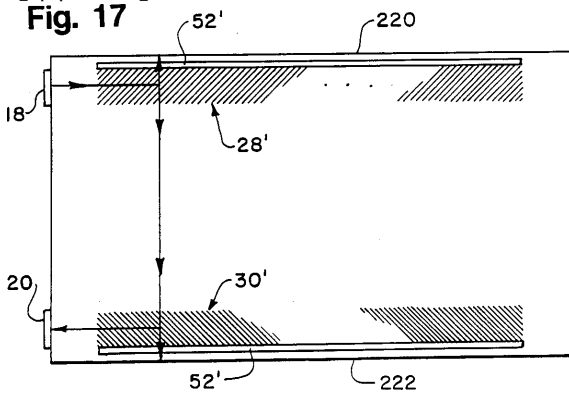
【図 15】  
Fig. 15



【図 16】  
Fig. 16

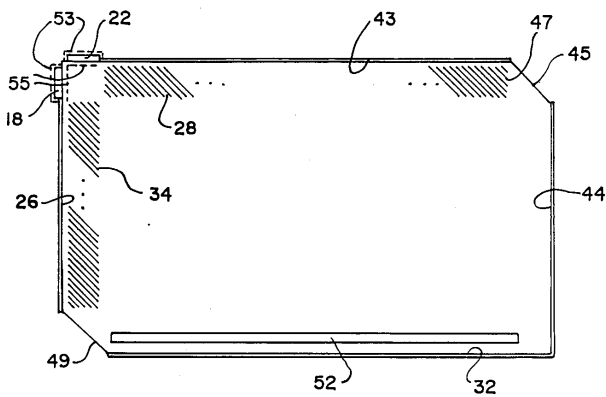


【図 17】  
Fig. 17



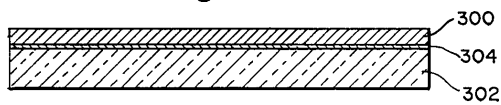
【図 19】

Fig. 19

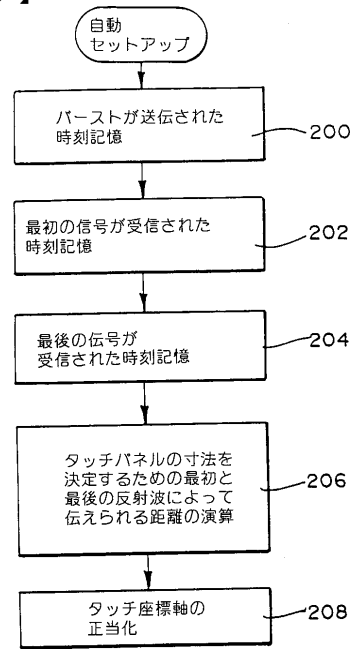


【図 20】

Fig. 20



【図 18】  
Fig. 18



---

フロントページの続き

合議体

審判長 大日方 和幸

審判官 治田 義孝

審判官 大野 克人

- (56)参考文献 米国特許第5 0 7 2 4 2 7 ( U S , A )  
特開平 2 - 1 1 0 6 2 0 ( J P , A )  
特開昭 6 1 - 3 9 1 2 1 ( J P , A )  
特開昭 6 2 - 2 9 3 4 1 7 ( J P , A )

- (58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, D B 名)  
G06F3/03 340